

## Presseinformation

6.6.2016

Wärmeableitung und Umweltschonung in einem Produkt vereint

### Henkel entwickelt wärmeleitfähige Technomelt-Lösung

Henkel Adhesive Technologies präsentiert einen weiteren Meilenstein in der Produktformulierung: Die Entwicklung eines wärmeleitfähigen Technomelt-Materials erweitert das Portfolio preisgekrönter Technomelt Hotmelt-Verkapselungsprodukte um eine zusätzliche Funktionalität. Wärmeleitfähige Technomelt-Produkte ermöglichen die Wärmeübertragung durch die Verkapselungsschicht hindurch und bieten damit zwei Funktionen in einer Materiallösung.

Technomelt-Materialien sind bereits als optimale einfache Alternative zu mehrstufigen, arbeitsintensiven Vergussverfahren anerkannt. Da sie bei niedrigen Drücken aufgeschmolzen, vergossen und abgekühlt werden können, bieten sie eine einzigartige Verkapselungslösung, die hohe Durchsätze ermöglicht und dabei empfindliche Schaltkreise und Leiterplattenmontagen durch Ausbildung eines geschlossenen Gehäuses schützt. Zu diesen Technomelt-inhärenten Vorteilen kommt jetzt noch die Wärmeleitfähigkeit für eine effektive Ableitung der Wärme von den Komponenten hinzu.

„Das Wärmemanagement gehört zu den größten Herausforderungen bei modernen Elektronikprodukten“, erklärt Art Ackerman, Global Product Manager Circuit Board Protection Materials bei Henkel. „Bei bestimmten Anwendungen dient eine zusätzliche Wärmeleitschicht ausschließlich der Verbesserung der Zuverlässigkeit und dauerhaften Leistungsfähigkeit – und das sind genau die Ziele, die wir mit dieser neuen Technomelt-Plattform verfolgen.“

Das erste kommerzielle Produkt aus dem neuen Technomelt-Portfolio hat eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 0,5 W/m-K und ist gut geeignet für Anwendungen wie LED-Treiberplatinen, Netzteile, Solar-Wechselrichter, Kameramodule oder Fahrzeugelektronik. Tests haben eine Absenkung der Bauteiltemperatur um 40 °C



gegenüber dem Standard-Technomelt gezeigt und damit die effektive Wärmeableitung belegt. Die neuen Technomelt-Materialien wurden gezielt für Vergussverfahren formuliert und basieren auf dem fundierten Henkel-Know-how in Sachen Hotmelt-Harze und Füllstofftechnologien. Sie bieten eine Schmelzviskosität, die mit Standard-Niederdruckvergussprozessen und -systemen kompatibel ist. Die Füllstoffdispersion bleibt über längere Zeit bei Schmelztemperaturen von über 180 °C erhalten.

„Das Henkel-Know-how im Bereich Wärmemanagement geht weit über herkömmliche Wärmeableitungslösungen hinaus“, sagt Ackerman und weist darauf hin, dass aktuelle und zukünftige Produktdesigns mehr denn je auf leistungsfähige Materialien angewiesen sein werden. „Diese neueste Technomelt-Formulierung belegt einmal mehr den Erfindungsgeist der Henkel-Chemiker und setzt Maßstäbe für die zukünftige Integration multifunktionaler Materialien.“

Weitere wärmeleitfähige Technomelt-Formulierungen für höhere Anforderungen an die thermische Belastbarkeit befinden sich bereits in der Entwicklung und werden Ende 2016 am Markt erwartet. Weitere Informationen finden Sie unter [www.henkel-adhesives.com/electronics](http://www.henkel-adhesives.com/electronics).

**Technomelt ist eine eingetragene Marke der Henkel-Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.**

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

**Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.com/press>**

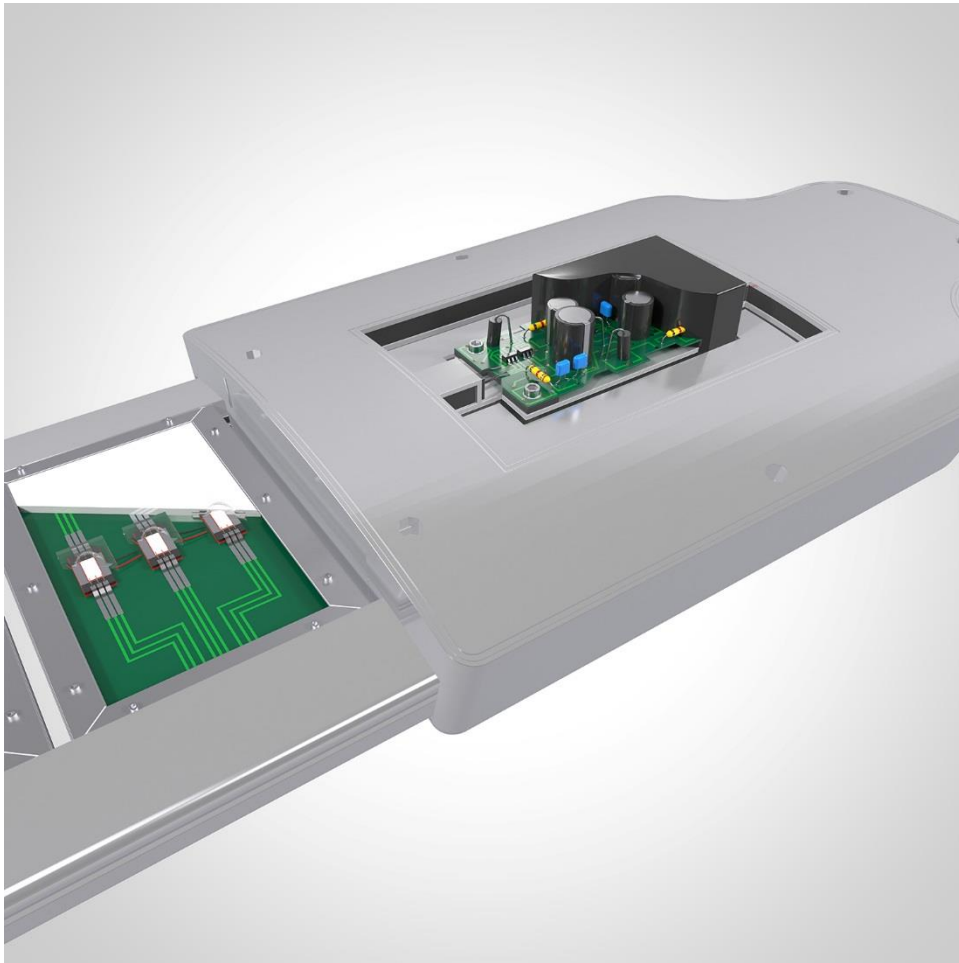
#### **Kontakt**

Henkel Adhesive Electronics  
**Eszter Marai**  
+49 211 797 7168  
[electronics@henkel.com](mailto:electronics@henkel.com)

Henkel Corporate Communications  
**Holger Elfes**  
+49 211 797-99 33  
[holger.elfes@henkel.com](mailto:holger.elfes@henkel.com)

Henkel AG & Co. KGaA

**Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:**



**Bildunterschrift:** Das neue wärmeleitfähige Technomelt-Material kombiniert Wärmeableitung und Verkapselung.